

Flip-Top™ BGA ソケット

アドバンス社の Flip-Top™ BGA ソケットは BGA デバイスのはんだ付けが不要で何度でも取り外し / 差し替えが出来る画期的なソケットです。ピッチは 0.50mm/1.00mm/1.27mm のご用意がございます。

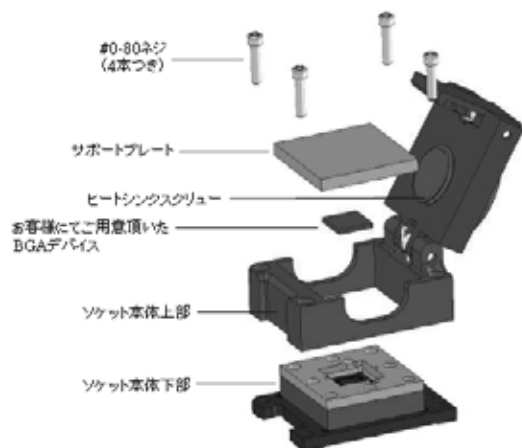


製品一覧

	<p>Mod5 Flip-Top™ BGA ソケット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・0.5mm ピッチ (FRM シリーズ) ・500 サイクル以上使用可能 ・デバイスサイズ: 2.5mm ~ 12mm 角まで 	<p>ソケット本体サイズ: 20mm×27mm 高さ: 約 17.4mm 本体材質: グラスファイバー入りサーモプラスチック ベースソケット材質: FR-4 グラスエポキシ UL94V-0</p>
	<p>Flip-Top™ BGA/LGA ソケット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1.00mm ピッチ (FRH シリーズ) ・500 サイクル以上使用可能 ・デバイスサイズ: 2.5mm 角 ~ ・接触ピンは表面実装 (SMT) タイプ、スルーホール (TH) タイプ選択可能 	<p>ソケット本体サイズ: デバイス縦幅+3mm×横幅+10mm (デバイス 15mm 角以上の場合) 本体材質: サーモプラスチック ベースソケット材質: FR-4 グラスエポキシ UL94V-0</p>
	<p>Flip-Top™ BGA/LGA ソケット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1.27mm ピッチ (FRG シリーズ) ・500 サイクル以上使用可能 ・デバイスサイズ: 2.5mm 角 ~ ・接触ピンは表面実装 (SMT) タイプ、スルーホール (TH) タイプ選択可能 	<p>ソケット本体サイズ: デバイス縦幅+3mm×横幅+10mm (デバイス 15mm 角以上の場合) 本体材質: 液晶ポリマー (LCP) ベースソケット材質: FR-4 グラスエポキシ UL94V-0</p>

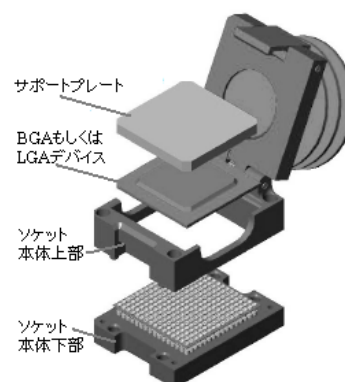
ソケットの構造

0.5mm ピッチ (FRM シリーズ)



- ①ソケット本体下部を基板へ実装する
- ②ソケット本体上部をネジ止める
- ③BGAデバイスを手もしくはバキュームポンプ(推奨)にてソケットに載せる
- ④サポートプレートをデバイスの上に乗せてフタを開め、スクリューを回してデバイスを損傷させる

1.00mm/1.27mm ピッチ (FRH/FRG シリーズ)



- ①本体下部を基板へ実装もしくはベースソケットを実装
- ②SMTの場合はソケット本体上部を下部に載せてネジ止めをし、THの場合はソケット本体をベースソケットへ載せる
- ③ソケットにデバイスを載せてフタを開める
- ④ヒートシンク/コイルスクリューを回してデバイスと接触させる

表面実装タイプは実装しやすくするため、本体上部/下部が組み立てられていませんが、スルーホールタイプは上部/下部が組み立てられた状態で出荷します。

お問い合わせ先: **株式会社 キャズテック**

〒164-0002 東京都中野区上高田 3-38-5Y.L.ビル TEL: 03-3387-7611 FAX:03-3388-7388

E-MAIL: info.mail@kaztech.co.jp